

マイクロン®組み込みアプリケーション向けMCPソリューション

アプリケーションのニーズを満たす当社のマルチチップパッケージ (MCP) メモリソリューション。製品ライフサイクル延長サポート、小型パッケージサイズ、低電源電圧オプション (1.8V および 1.2V)、温度拡張製品など、ユニークな製品ポートフォリオから選択できます。

マイクロン MCP パッケージ							
BGA パッケージ(mm) (上記のパッケージ写真は実際のサイズ)	121 ボール 8 x 7.5	130 ボール 8 x 9	137 ボール 10.5 x 13	162 ボール 8 x 10.5	162 ボール 11.5 x 13	168 ボール 12 x 12 (PoP)	221 ボール 11.5 x 13
e.MMC + LPDDR3							
8GB e.MMC + 8Gb LPDDR3						✓	✓
e.MMC + LPDDR2							
4GB e.MMC + 4Gb LPDDR2					✓	✓	
NAND + LPDDR3							
4Gb NAND + 8Gb LPDDR3							✓
NAND + LPDDR2							
4Gb NAND + 4Gb LPDDR2				✓			
4Gb NAND + 2Gb LPDDR2				✓			
2Gb NAND + 2Gb LPDDR2				✓			
2Gb NAND + 1Gb LPDDR2				✓			
1Gb NAND + 1Gb LPDDR2	✓						
1Gb NAND + 512Mb LPDDR2	✓						
NAND + LPDDR							
8Gb NAND + 4Gb LPDDR						✓	
4Gb NAND + 4Gb LPDDR						✓	
4Gb NAND + 2Gb LPDDR		✓	✓			✓	
2Gb NAND + 1Gb LPDDR		✓	✓				
1Gb NAND + 512Mb LPDDR		✓					

製品は、マイクロンの製品データシート仕様を満たしている場合に限り保証されます。情報、製品、仕様は事前の通知なく変更されるものとします。日付は目安として提供されています。Micron および Micron のロゴは Micron Technology, Inc. の商標です。その他の商標はそれぞれの所有者に属します。Rev. C 12/16 CCMMD-676576390-3922

